

2014年3月期(2013年4月～2014年3月)

東京エレクトロン 決算説明会

内容:

➤ 2014年3月期 連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

➤ 2015年3月期 事業戦略および上期業績予想

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年4月28日

2014年3月期(2013年4月～2014年3月)

連結決算の概要

取締役執行役員 原田 芳輝

2014年4月28日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 28, 2014



損益状況

(億円)

	2013年3月期	2014年3月期	対前年 増減率	(ご参考) 12/18修正の 2014年3月期予想
売上高	4,972	6,121	+23%	6,050
売上総利益 下段: 売上総利益率	1,587 31.9%	2,018 33.0%	+27%	-
販管費	1,462	1,696	+16%	-
営業利益 下段: 営業利益率	125 2.5%	322 5.3%	+157%	300 5.0%
税前利益	177	-117	-295億円	-150
当期純利益	60	-194	-254億円	-220
1株当たり当期純利益(円)	33.91	-108.31	---	-122.78
研究開発費	732	786	+7%	770
設備投資額	217	127	-41%	170
減価償却実施額	266	248	-7%	300

下期、半導体製造装置事業の売上および利益率が改善 PVE事業撤退、国内事業所再編に伴い、特別損失を計上

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

2

部門別売上高

(億円)

	2013年3月期		2014年3月期		対前年増減率
	売上高	構成比	売上高	構成比	
SPE	3,920	79%	4,788	78%	+22%
FPD	200	4%	283	5%	+41%
PVE	0	0%	38	1%	---
EC/CN	846	17%	1,007	16%	+19%
その他	4	0%	4	0%	+7%
合計	4,972	100%	6,121	100%	+23%

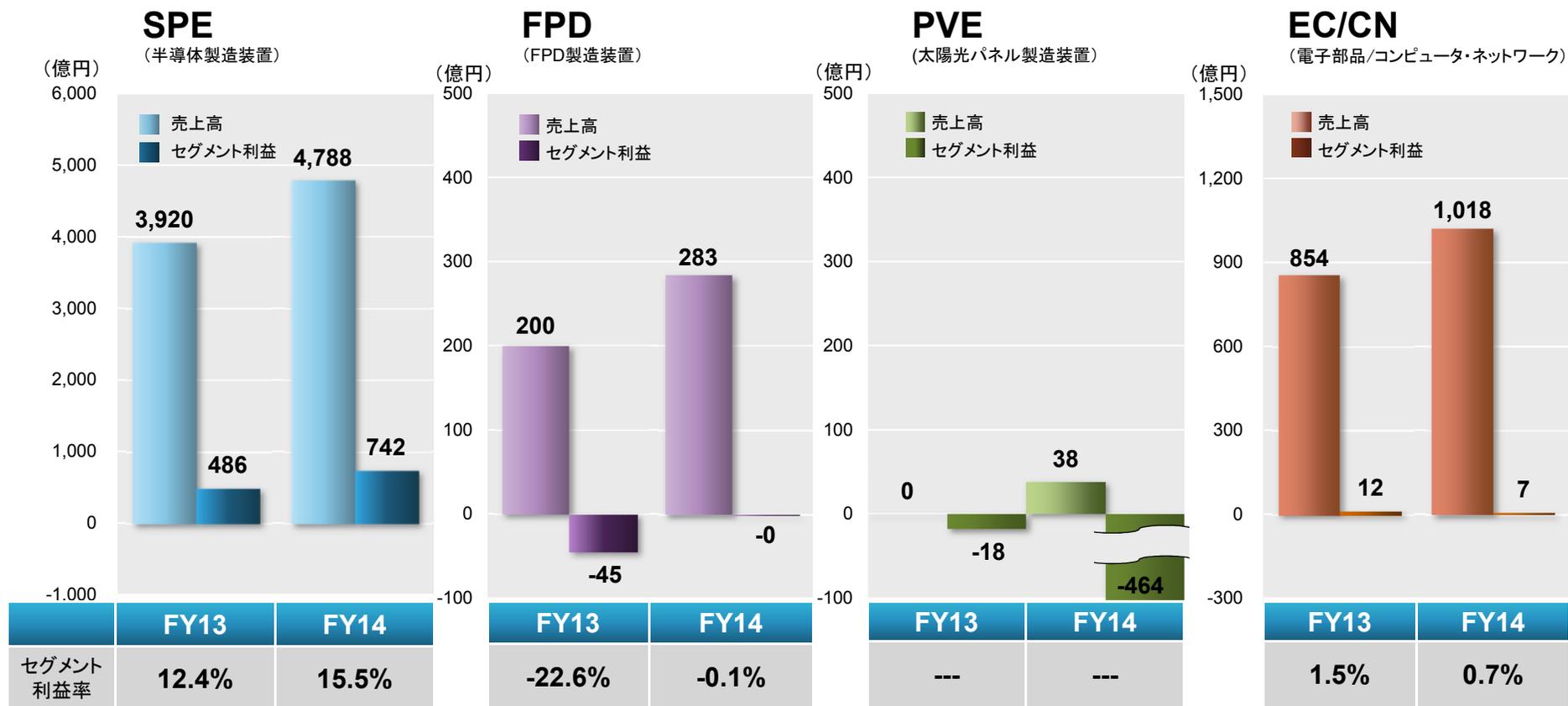
SPE (半導体製造装置) アジア全域で売上が前年比回復。特に下期の台湾・中国における先端投資が回復を牽引。

FPD (FPD製造装置) 下期より中国向けを中心に売上が回復基調に。

PVE (太陽光パネル製造装置) 2014年3月で事業撤退。(納入済み装置に対するサポートは維持)

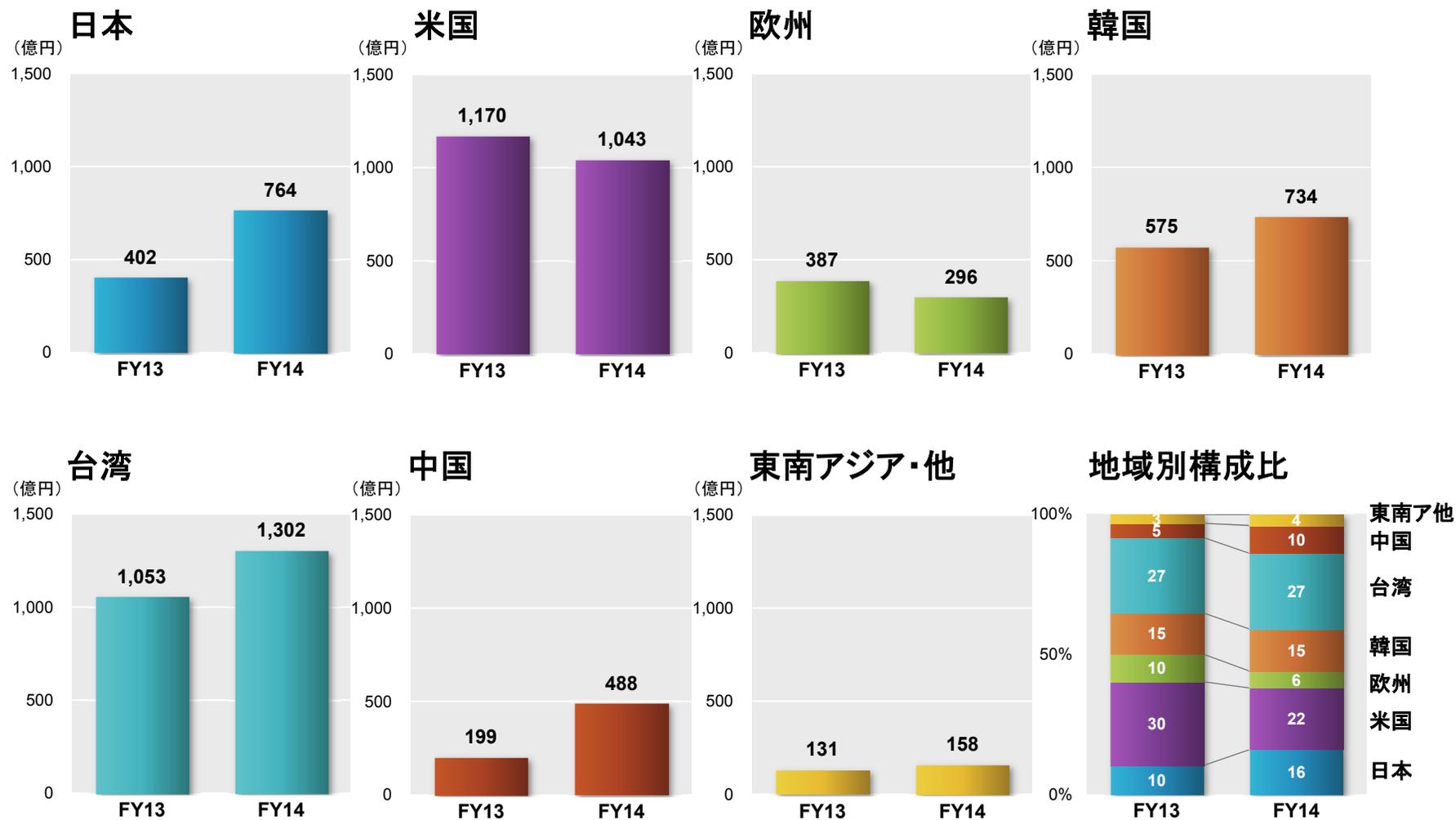
EC/CN (電子部品/コンピュータ・ネットワーク) 産業機器関連市況の好転と商権拡大により売上増加。(2015年3月期より持分法適用)

セグメント情報



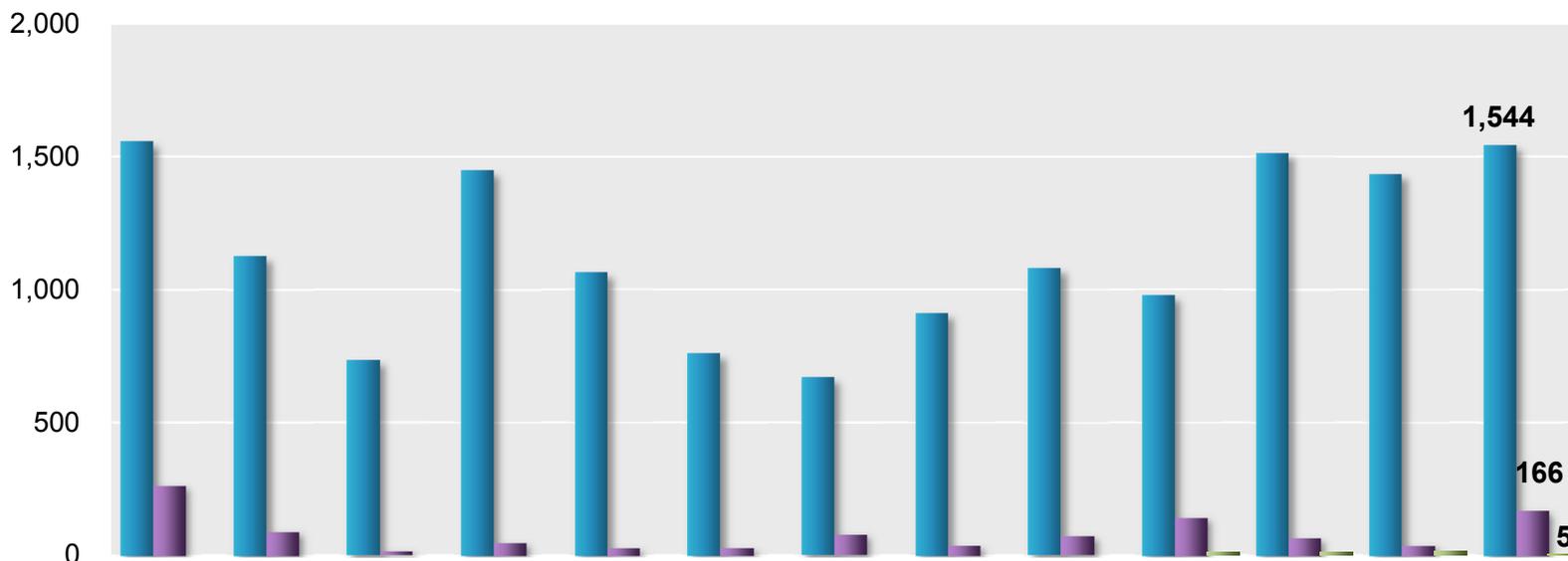
1. 従来のFPD/PVEセグメントを、FPDとPVEに分けて開示しています。FY2013については遡及し、組み替えて表示しています。
2. 上記報告セグメントに配分していない基礎研究費および減損損失等を全社費用としています。(FY13; 270億円 FY14; 415億円)
3. セグメント利益は、税前利益です。

SPE部門地域別売上高



受注額・受注残高

(億円)

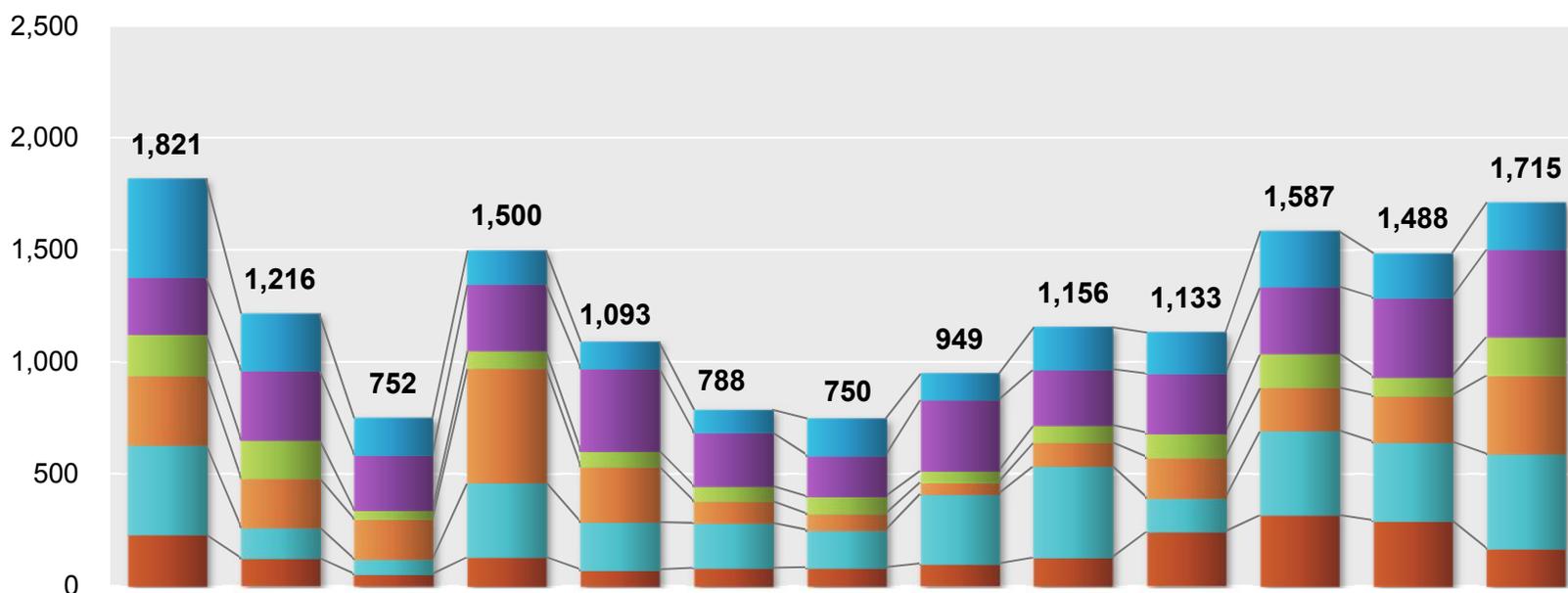


	FY11 4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q
■ SPE受注額	1,558	1,126	735	1,449	1,064	760	669	913	1,082	977	1,513	1,434	1,544
■ FPD受注額	263	89	17	50	28	27	80	36	73	144	63	38	166
■ PVE受注額						0	0	0	0	11	11	14	5
SPE受注残高	2,289	2,207	1,667	2,201	1,886	1,577	1,187	1,426	1,416	1,645	1,960	2,372	2,099
FPD受注残高	654	618	394	278	142	122	158	148	160	255	274	225	290
PVE受注残高						0	-	84	84	76	74	77	89

FY12/4Q以前のPVEの受注額および受注残高はFPDとの合計額で表示しています。

地域別受注額：SPE+FPD+PVE

(億円)

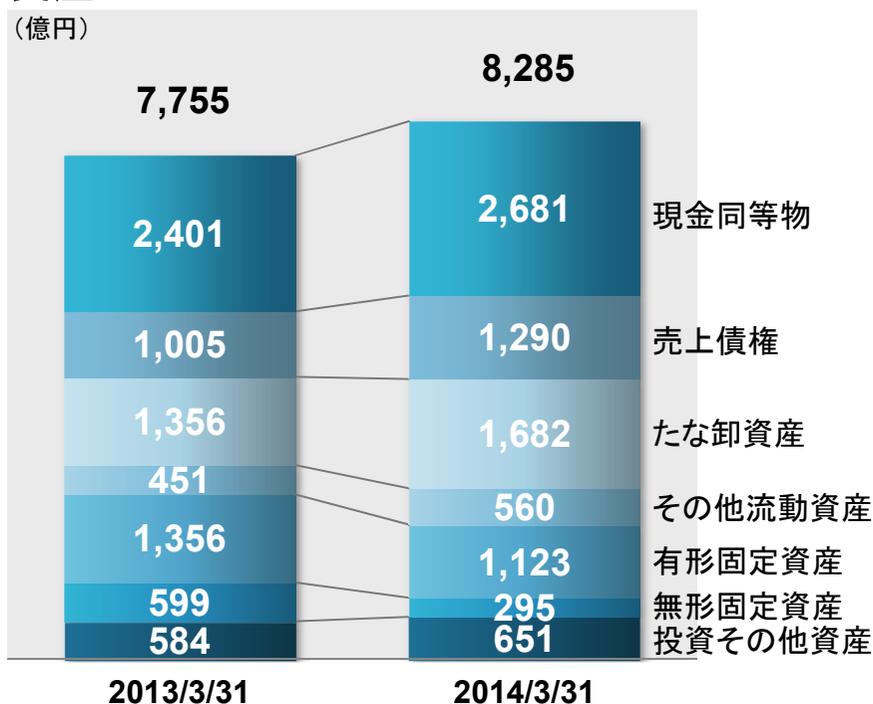


	FY11 4Q	FY12 1Q	2Q	3Q	4Q	FY13 1Q	2Q	3Q	4Q	FY14 1Q	2Q	3Q	4Q
■ 国内	439	250	163	149	117	100	163	115	187	183	247	196	209
■ 米国	254	311	248	297	368	240	184	317	249	264	298	353	389
■ 欧州	186	172	39	76	70	68	77	50	77	109	153	85	175
■ 韓国	307	219	179	511	251	97	73	52	105	182	191	206	350
■ 台湾	403	137	66	335	210	200	167	313	410	149	378	352	423
■ 中国・東南ア他	229	125	54	129	74	81	83	100	127	244	317	293	167

貸借対照表

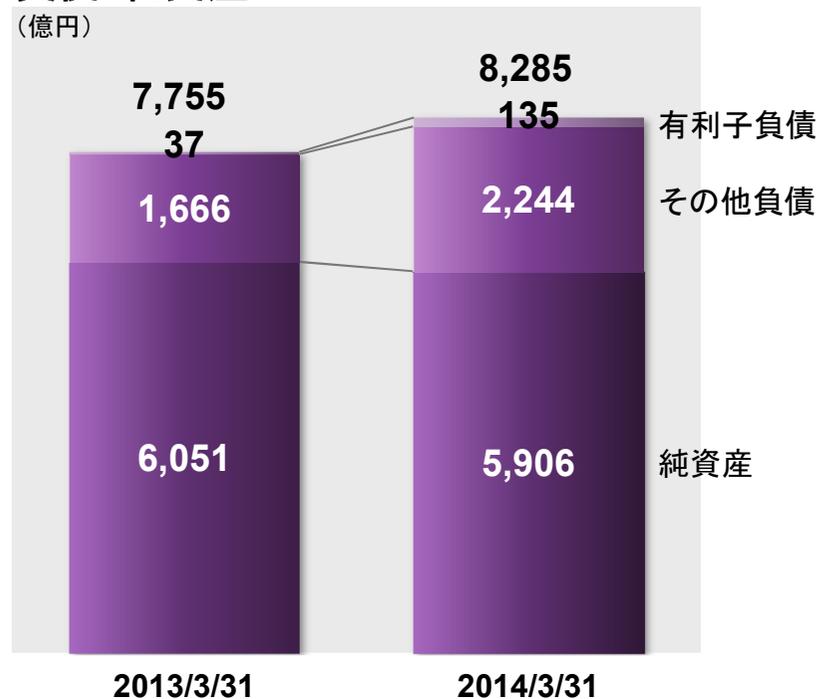
資産

(億円)



負債・純資産

(億円)



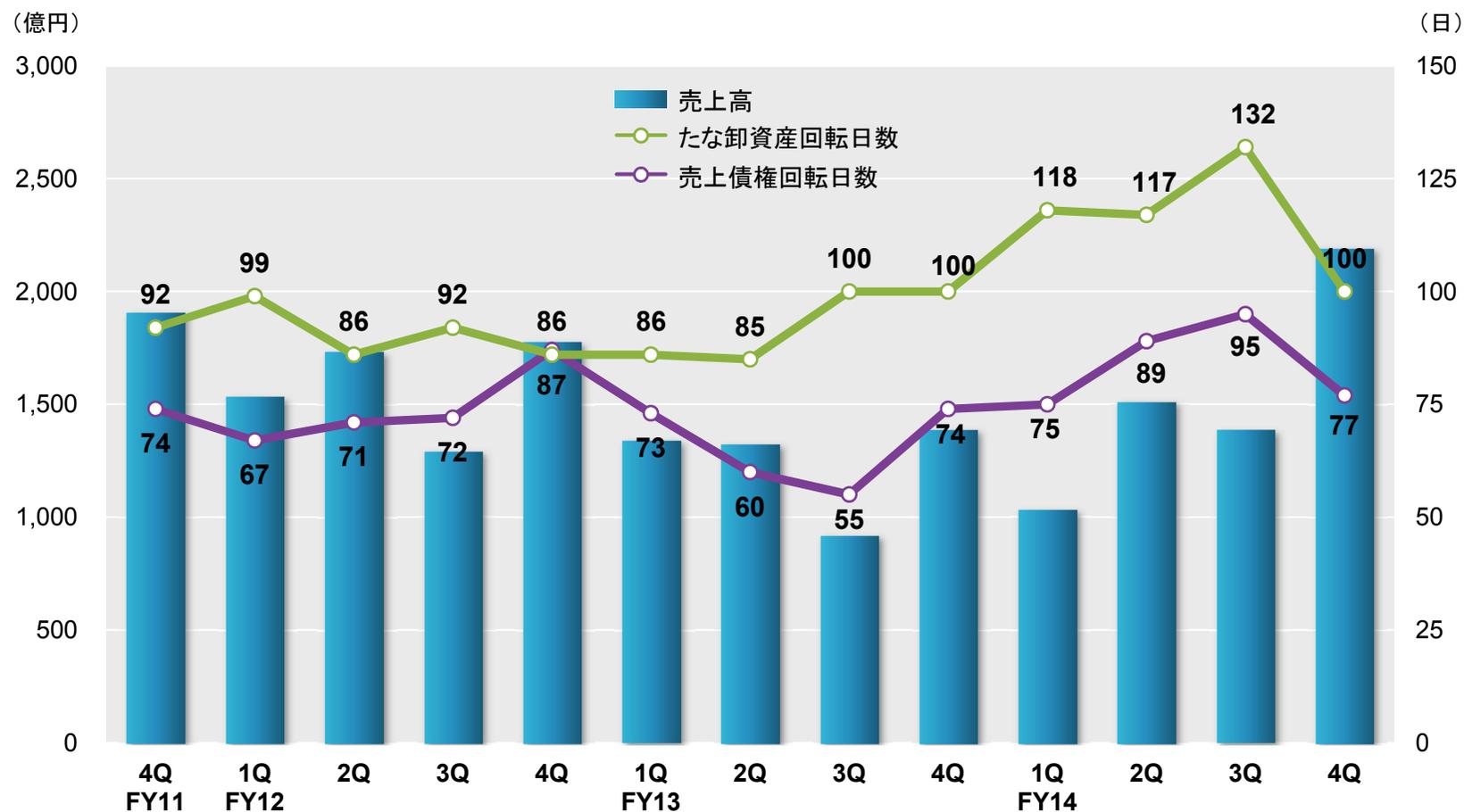
主な増減

(億円)

		増減	主な要因
資産	売上債権	+285	売上増に伴う増加
	たな卸資産	+325	生産増および出荷済み未設置在庫の増加
	無形固定資産	-303	減損 - PVE(-316), NEXX(-50)
	現金同等物	+280	
負債	その他負債	+578	前受金の増加(+209), 買掛金の増加(+174), 未払法人税等の増加(+117)

現金同等物: 現預金 + 短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

たな卸資産・売上債権の回転日数



回転日数 = 売上債権もしくはたな卸資産 ÷ 各四半期末までの12ヶ月間売上高 × 365

キャッシュ・フロー

	2013年3月期	2014年3月期	(億円)
営業キャッシュ・フロー	842	444	
税引前利益	177	△117	
減価償却費	266	248	
減損損失	0	469	
売上債権の減少(△増加)	575	△253	
たな卸資産の減少(△増加)	202	△320	
仕入債務の増加(△減少)	△154	156	
法人税等の支払額または還付額	△76	△17	
その他	△148	279	
投資キャッシュ・フロー	△1,417	△195	
設備投資	△190	△94	
企業買収に伴う株式取得等による支出	△561	-	
満期3ヵ月超の預金等の増減額	△660	△85	
その他	△5	△16	
財務キャッシュ・フロー	△106	△1	
配当金支払い	△93	△91	
その他	△13	89	
現金及び現金同等物の期末残高	853	1,047	
満期3ヵ月超の定期預金・短期投資の期末残高	1,548	1,633	
現金及び現金同等物＋満期3ヵ月超の定期預金・短期投資等の期末残高	2,401	2,681	

補足資料



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 28, 2014



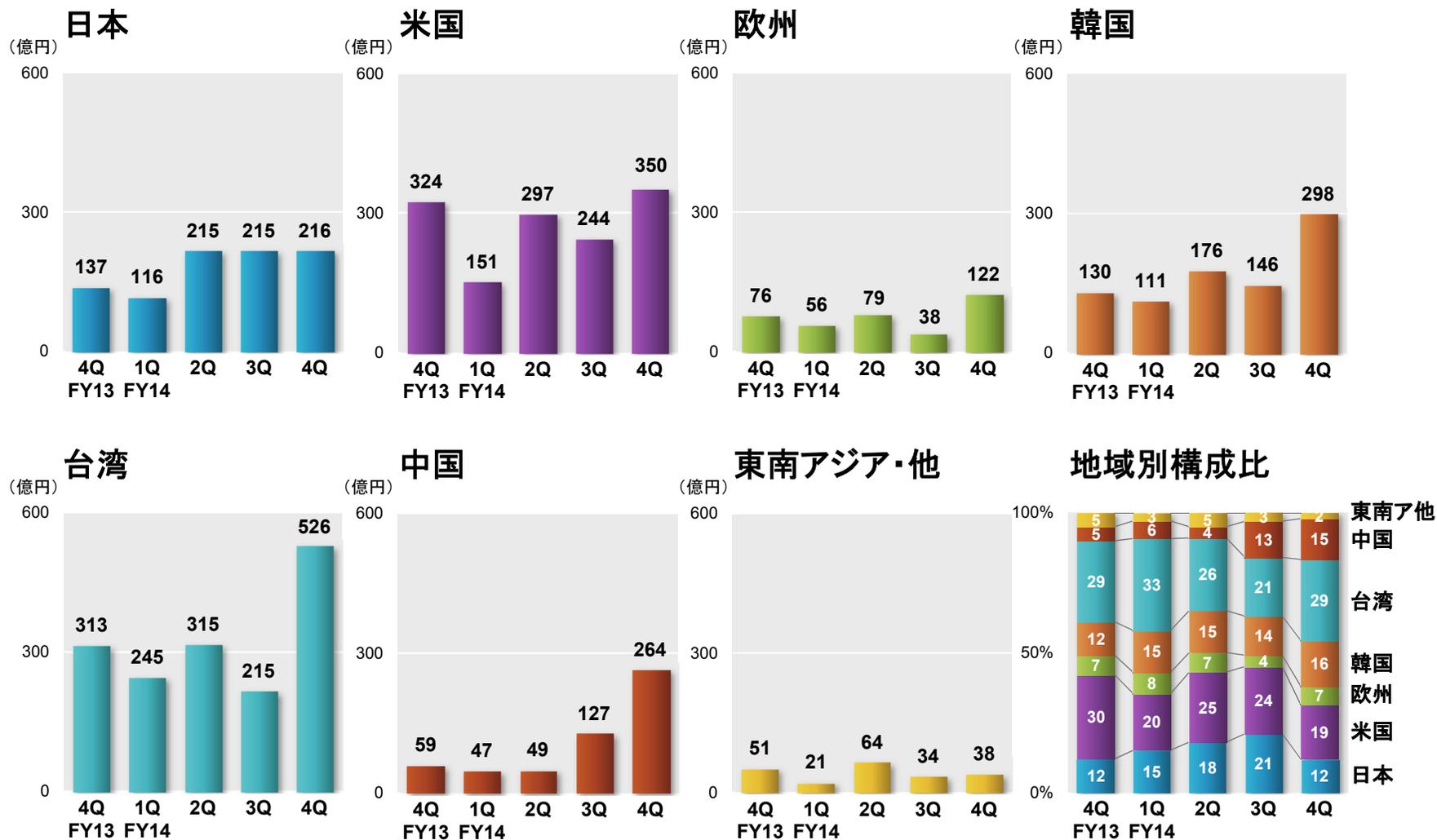
業績サマリー

(億円)

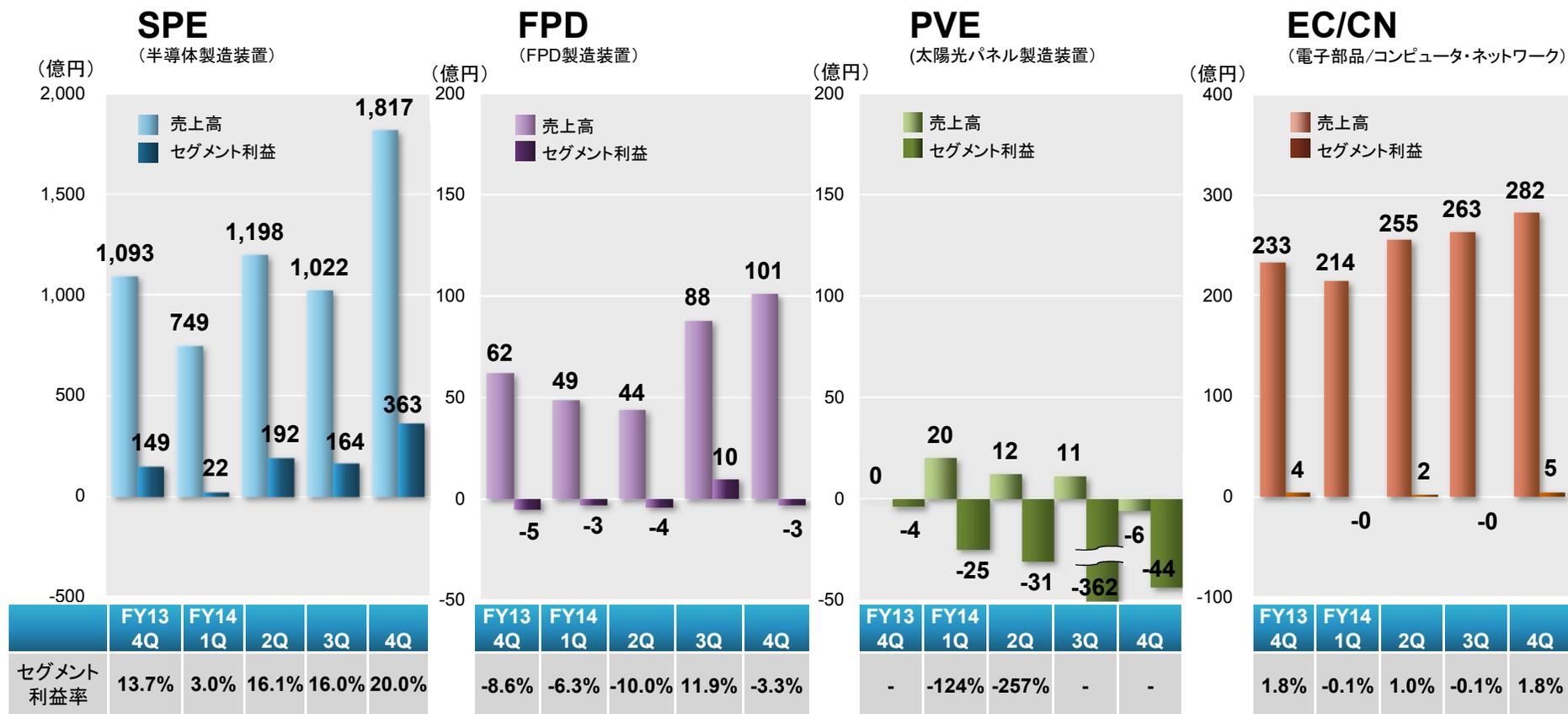
	2013年3月期	2014年3月期					対前年4Q 増減率
	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		
売上高	1,387	1,034	1,510	1,384	2,192	+58%	
SPE	1,093	749	1,198	1,022	1,817	+66%	
FPD	62	49	44	88	101	+62%	
PVE	0	20	12	11	-6	---	
EC/CN	230	214	253	260	279	+21%	
その他	1	1	1	0	1	+1%	
売上総利益	448	299	501	503	715	+59%	
下段:売上総利益率	32.3%	28.9%	33.2%	36.4%	32.6%		
販管費	376	395	423	412	465	+24%	
営業利益	72	-96	78	90	249	+246%	
下段:営業利益率	5.2%	-9.3%	5.2%	6.6%	11.4%		
税前利益	84	-98	95	-372	257	+206%	
当期純利益	70	-29	54	-380	162	+131%	
研究開発費	183	179	204	189	212	+16%	
設備投資額	29	47	19	14	45	+54%	
減価償却実施額	82	63	64	58	62	-24%	

1. 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。
2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

SPE部門地域別売上高



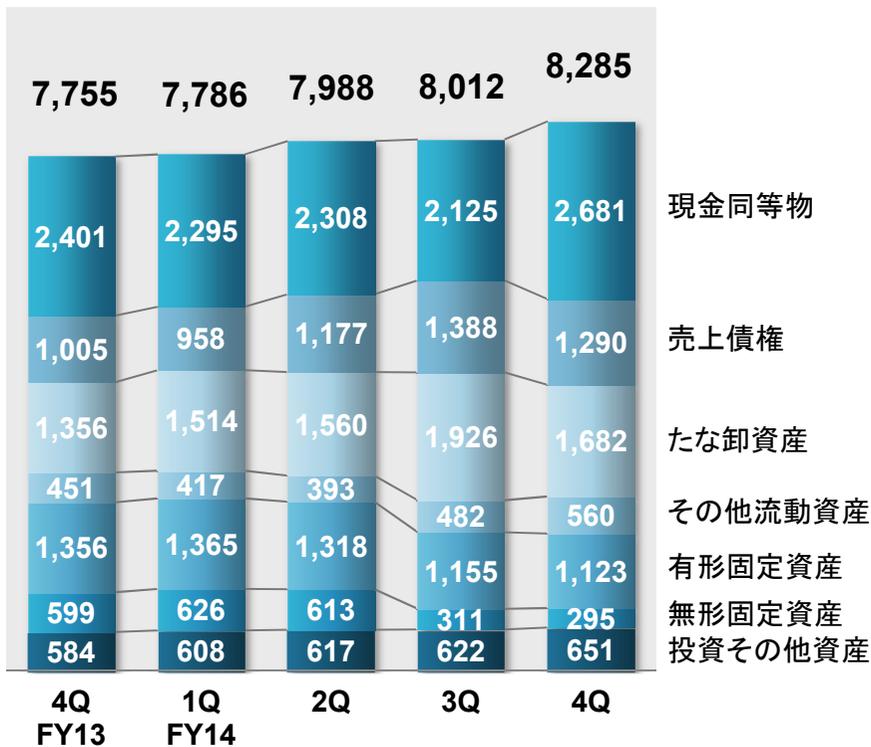
セグメント情報



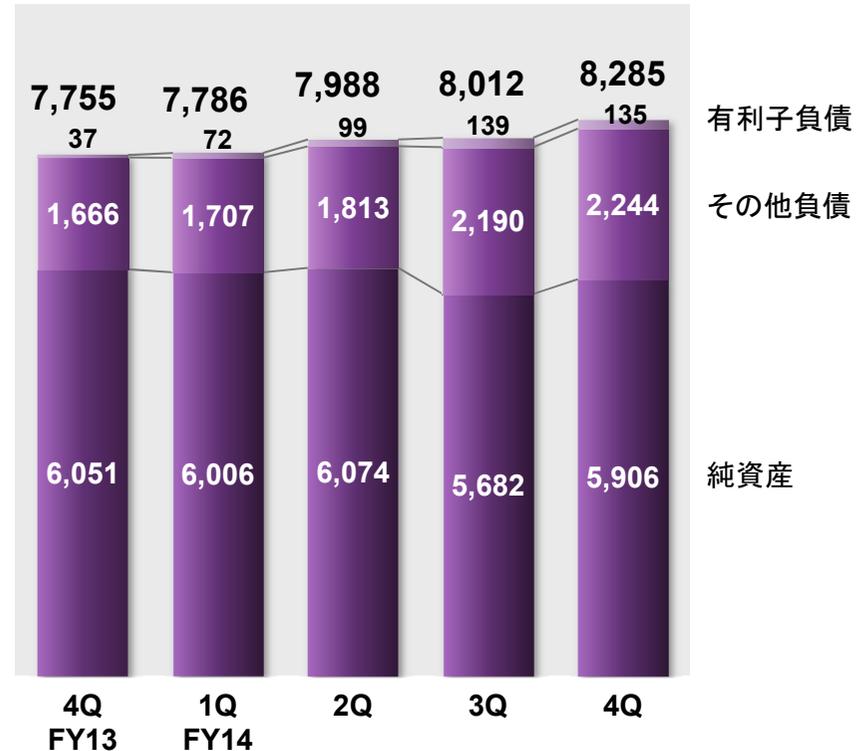
1. 従来のFPD/PVEセグメントを、当第1四半期よりFPDとPVEに分けて開示しています。FY2013については遡及し、組み替えて表示しています。
2. セグメント利益は、税前利益です。
3. 上記報告セグメントに配分していない全社費用(主に基礎研究又は要素研究等の研究開発費)があります。
4. PVEセグメントについては、4Qで工事進行基準売上高の進捗度を再精査しました。

貸借対照表

資産
(億円)



負債・純資産
(億円)



現金同等物: 現預金+短期投資等 (貸借対照表上の表示は「有価証券」)

従業員数

(人)

	2013年3月末	2014年3月末
国内	8,186	8,205
米国	1,633	1,652
欧州	888	888
アジア	1,494	1,559
合計	12,201	12,304



2015年3月期 事業戦略および 上期業績予想

代表取締役会長兼社長、CEO 東 哲郎

2014年4月28日



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 28, 2014



2014年3月期 ハイライト



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 28, 2014



2014年3月期 ハイライト

▶ アプライド マテリアルズとの経営統合発表(2013/9/24)

目的

- 顧客の直面する高次元の課題にソリューションを提供
- 相互に補完し合う両社の最先端技術と製品で、半導体およびディスプレイ産業に大きく貢献
- 収益性向上に向けた両社共通のコミットメント
- 統合により、さらなる株主還元を実現

進捗

- 統合直後から最適なオペレーションを開始するための統合準備チーム(IMO)を発足
- 両社の統合に関する登録届出書を米国証券取引委員会に提出
- 統合完了は、2014年の半ばから後半を予定

2014年3月期 ハイライト

▶ 事業再編と拠点最適化を実施

- PVE事業からの撤退
 - 2014年3月末をもって開発・製造・販売活動を停止。納入済み装置のサポート業務のみ継続。
- 開発拠点の集約
 - テクノロジーセンターつくばを閉鎖
 - テクノロジーセンター仙台を東京エレクトロン宮城へ集約
- 東京エレクトロン デバイス株式の一部売却を発表
 - コアビジネスである装置事業に経営資源の一層の集中

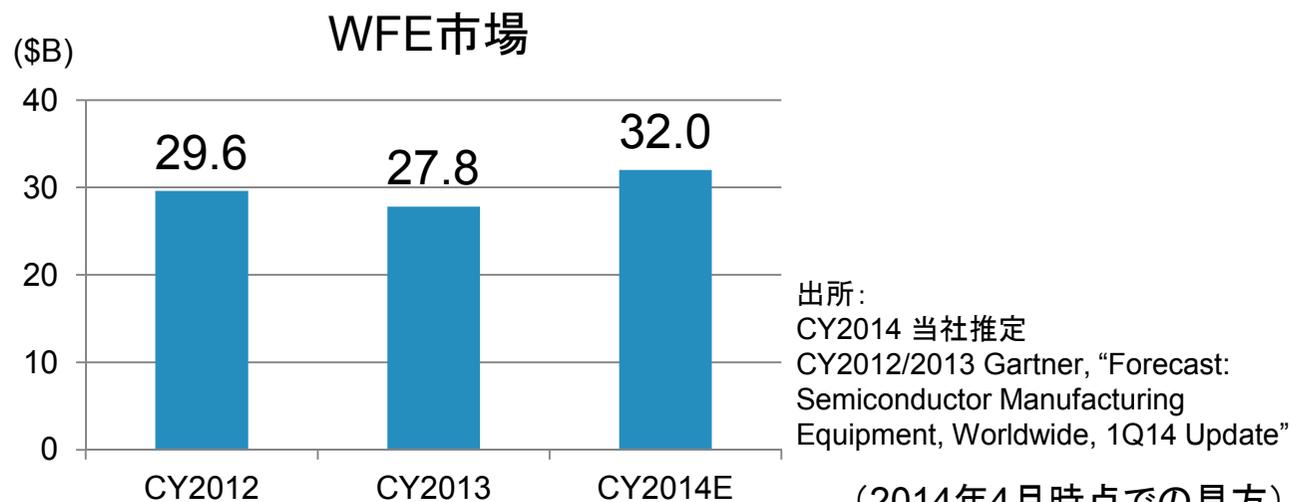
市場環境と事業戦略

SPE市場環境

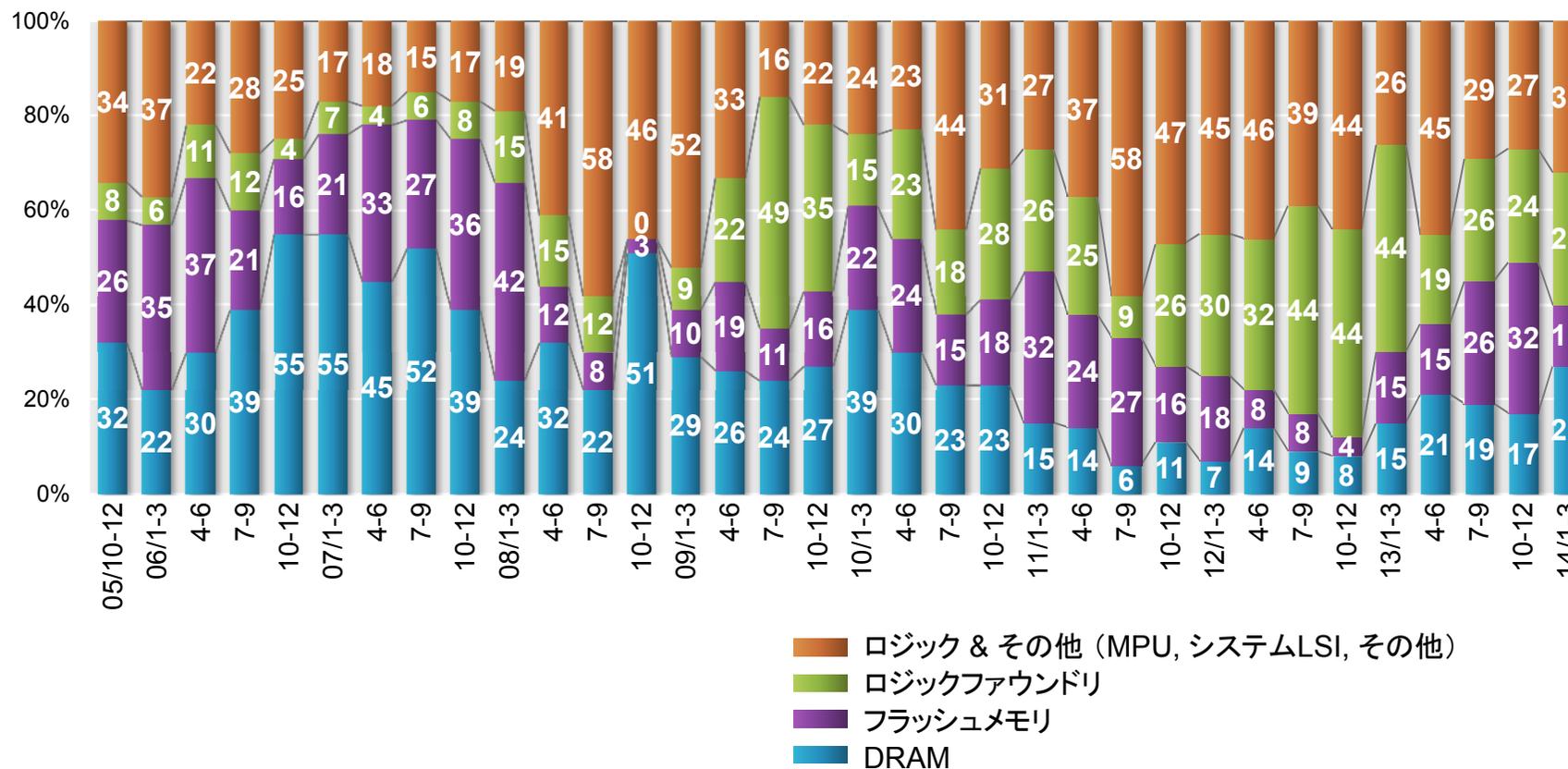
▶ 半導体設備投資

CY2014の半導体前工程(WFE)の設備投資額は、前年比+15%前後を見込む。モバイル機器市場は台数ベースで対前年比+20%と予測されており、特にメモリ向け設備投資が拡大すると予測。

- DRAM/NAND: モバイル機器が引き続き需要を牽引し設備投資は拡大
- ファウンドリ: モバイル機器向け半導体設備投資は対前年比増加
- ロジック: PC市場縮小の中でWFE設備投資は前年並み



アプリケーション別SPE受注額



グラフは装置本体受注における構成比を示しています。

2014年3月期 SPE事業について

▶ WFEにおけるシェアについて

	CY2012	CY2013	増減
市場シェア	13.2%	10.5%	△2.7 pts

(出所: Gartner, "Market Share: Semiconductor Manufacturing Equipment, Worldwide, 2013")

シェア減少の背景

- 為替換算レート差による影響(79円⇒97円)
- 売上認識基準による影響(出荷基準／設置完了基準)
- 製品ミックス、顧客ミックス

SPE事業戦略

エッチング装置

▶ 前期の結果

- 2012年比シェア減少: 製品ミックス(シリコンエッチ市場の拡大)
- RLSA装置が複数顧客の評価を得る

▶ 今期の重点課題

- 継続して市場拡大が見込まれるシリコンエッチに注力
- FinFET工程でRLSA装置の顧客展開、NANDの採用工程拡大
- マルチパターニング工程でポジション拡大



プラズマエッチング装置
Tactras™ RLSA™ Etch

熱処理成膜装置

▶ 前期の結果

- 2012年比シェア減少: 製品ミックス、顧客ミックス
- 大手ロジックメーカーに新規参入

▶ 今期の重点課題

- 拡大が見込まれるALD市場でシェア拡大
- 最新モデル(NT333)で採用アプリケーションの拡大



ALD成膜装置
NT333™

SPE事業戦略

洗浄装置

▶ 前期の結果

- 2012年比シェア微増:顧客・製品展開が計画通り進捗、注力工程でポジション獲得 (シェア貢献はCY2014)

▶ 今期の重点課題

- メモリーにおいて当社独自技術の顧客展開を図る
- ロジックの配線工程でポジション拡大
- FinFET工程でドライ洗浄の工程数拡大



枚葉洗浄装置
CELLESTA™-i

コータ/デベロッパ

▶ 前期の結果

- 2012年比シェア高位維持:
先端液浸プロセス装置市場で、欠陥対策機能で高評価獲得

▶ 今期の重点課題

- 液浸10nmノード以細向けパターンニング技術開発
- 次世代リソグラフィー技術(EUV/DSA)向けの開発強化継続



コータ/デベロッパ
CLEAN TRACK™
LITHIUS Pro™ Z

EUV: extreme ultraviolet, DSA: directed self-assembly

SPE事業戦略

枚葉成膜装置

▶ 今期の重点課題

- メタルALD市場が拡大。薄膜制御性、低温、均一性に優れたメタル成膜装置 (Triase+ EX-II) でシェア拡大に取り組む
- ロジックにおけるポジション向上

テストシステム

▶ 今期の重点課題

- NAND向けテスター一体型マルチセルテストシステムを市場投入。省フットプリントと高テスト性能により顧客の大幅なテストコスト削減を実現する新製品で収益拡大を目指す。



テスター一体型テストシステム
Cellcia™

- テストコスト20%以上削減
- 複数ウェーハを同時テスト

FPD市場環境と事業戦略

▶ FPD設備投資

- CY2014の液晶パネル用製造装置の需要は、中国での大型パネル向け設備投資を中心に引き続き堅調。また、有機ELテレビ市場の立ち上がりは2016年以降。

▶ 事業戦略

- 最新モデルICPエッチング装置を顧客展開。高精細パネル(4K)、OLED等の新しい技術ニーズに対応した差別化製品により、収益拡大を目指す。
- インクジェット方式の有機EL成膜装置の販売開始。



有機ELパネル製造用インクジェット描画装置
Elius™ 2500

- 材料使用効率に優れる
- 大気圧下でのプロセスが可能

2015年3月期 上期業績予想



TOKYO ELECTRON

CORP IR/April 28, 2014



2015年3月期 上期業績予想

(億円)

	FY2015 上期 (予想)
売上高	2,780
SPE	2,600
FPD	160
PVE	20
その他	0
営業利益	180
下段: 営業利益率	6.5%
税前利益	155
当期純利益	110
1株当たり 当期純利益 (円)	61.38

- 配当予想
 - 第1四半期配当10円を予定
- 下期業績見込み
 - 売上高3,070億円、営業利益480億円

※アプライド マテリアルズとの経営統合を2014年の半ばから後半に予定しているため、上期までの業績予想を開示しています。

まとめ

1. CY2014 WFEは、前年比15%の増加を見込む。モバイル機器に牽引され、メモリ、ファウンドリ顧客の投資は引き続き旺盛
2. FinFET、3D NAND、マルチパターンニング等の新技術に対応する製品展開を強化
3. エッチング装置、熱処理成膜装置のシェア改善に注力
洗浄装置は計画通りビジネスが拡大
4. SPE/FPD事業に経営資源を集中し、利益改善に取り組む
5. アプライド マテリアルズとの経営統合完了は、予定通り
2014年の半ばから後半を見込む

▶ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

▶ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

▶ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV:フラットパネルディスプレイ及び太陽光パネル

50 Years